

Pressa A Caldo Automatica Sottovuoto Da 10T Per La Compressione Di Precisione In Laboratorio

Numero articolo: XP32



introduzione

Pressa a caldo automatica sottovuoto da 10T da banco ad alta precisione, con piastre riscaldate da 200x200 mm e pompa per vuoto rapida, ideale per polimerizzazione, incollaggio di elettrodi per batterie e ricerca sui materiali. Perfetta per ambienti di laboratorio che richiedono riscaldamento uniforme e controllo preciso della pressione, certificata CE e con touchscreen programmabile.

[Ulteriori informazioni](#)

Applicazione	Descrizione	Vantaggio principale
Laminazione di film polimerici	Laminazione di fogli o film polimerici sotto calore e vuoto per creare strutture multistrato.	Pressione e temperatura uniformi prevengono deformazioni e vuoti.
Incollaggio di elettrodi per batterie	Incollaggio di materiali per elettrodi sui collettori di corrente per batterie agli ioni di litio o allo stato solido.	Lo spurgo con gas inerte previene l'ossidazione, garantendo un'elevata conducibilità.
Compattazione di polveri (con stampi)	Compattazione di polveri metalliche, ceramiche o composite in pellet densi utilizzando uno stampo più piccolo.	È possibile ottenere una pressione elevata fino a 50,9 MPa con uno stampo da Ø50 mm.
Lavorazione di film sottili	Polimerizzazione e ricottura di film sottili per applicazioni elettroniche e di sensori.	Controllo preciso della temperatura fino a 300°C in ambiente sottovuoto.
Sinterizzazione di ceramiche	Sinterizzazione della fase iniziale di corpi verdi ceramici sotto l'azione combinata di calore e pressione.	Ridotta porosità e migliori proprietà meccaniche.
Polimerizzazione di materiali compositi	Polimerizzazione di prepreg di fibra di carbonio o fibra di vetro.	La distribuzione uniforme della pressione garantisce una qualità di laminazione elevata.
Incapsulamento di elettronica organica	Incapsulamento di dispositivi elettronici organici sensibili in atmosfera inerte.	L'ambiente privo di ossigeno prolunga la durata del dispositivo.

Parametro	Specifica	Note
Modello	XP32	Pressa sottovuoto riscaldata automatica
Pressione di lavoro massima	≤ 10 Tonnellate (100 kN)	Controllata tramite sistema programmabile
Precisione della pressione	± 0,1 Tonnellate (1 kN)	Feedback di carico ad alta precisione
Temperatura di lavoro delle piastre	Temperatura ambiente (RT) - 300 °C	Touchscreen PID programmabile
Potenza di riscaldamento	3500 W	Array di elementi riscaldanti ad alta densità
Dimensioni piastre	200 mm x 200 mm	Piastre rettificate
Apertura piastre (luce libera)	50 mm	Apertura compatta per cicli di vuoto rapidi
Pompa per vuoto inclusa	Pompa meccanica a palette rotanti	Inclusione standard
Portata pompa per vuoto	240 L/min (8,5 CFM)	Capacità di evacuazione ad alta velocità

Parametro	Specifica	Note
Grado di vuoto finale	<-0,1 MPa	Pressione manometrica relativa
Atmosfera di lavoro	Azoto (N ₂) / Argon (Ar)	Compatibile con ciclo vuoto e spurgo
Alimentazione	AC 208V / 60Hz (Monofase)	Ottimizzata per strutture istituzionali statunitensi
Certificazione	Certificata CE	Conformità di sicurezza standard

Opzione	Controller standard (incluso)	Aggiornamento PLC industriale avanzato (opzionale)
Interfaccia	Touchscreen a colori da 7 pollici	PLC industriale Siemens con touchscreen ad alta risoluzione
Funzioni principali	Profilazione di base della temperatura PID, inserimento pressione target, mantenimento automatico, decompressione temporizzata automatizzata	Profilazione complessa a più fasi di temperatura/pressione, archiviazione ricette (fino a 99 profili), feedback preciso dalla cella di carico, registrazione dati tramite Ethernet
Migliore per	Laminazione standard, polimerizzazione di polimeri, pressatura semplice di pellet	Ricerca accademica, standard di prova ASTM, processi che richiedono una compensazione precisa della pressione passo dopo passo